

「TILOG-LOGISTIX2017」、「Pack Expo2017」、「CSS2017&SEED EXPO」に出展します。

オークラグループは、海外展示会「TILOG-LOGISTIX2017」、「Pack Expo2017」、「CSS2017&SEED EXPO」に出展します。
ご来場の際には、是非弊社ブースにお立ち寄りください。

「TILOG - LOGISTIX 2017」の展示会概要

出展者	TRUE Okura CO., Ltd. (Thailand)
開催日時	2017年8月16日(水)～18日(金)
会場	Bangkok International Trade and Exhibition Center (BITEC), Bangkok, Thailand
オークラブース	D-06ブース
出展内容	ロボットパレタイザ、軽搬送コンベヤライン、ケース搬送コンベヤライン
その他	主催者のホームページは こちら からご確認ください。

「Pack Expo 2017」の展示会概要

出展者	Columbia/Okura, L.L.C.(U.S.A)
開催日時	2017年9月25日(月)～27日(水)
会場	Las Vegas Convention Center
オークラブース	C-2836ブース
出展内容	ロボットパレタイザ
その他	主催者のホームページは こちら からご確認ください。

「CSS2017 & SEED EXPO」の展示会概要

出展者	Columbia/Okura, L.L.C.(U.S.A)
開催日時	2017年12月4日(月)～8日(金)
会場	Hyatt Regency Chicago, IL
オークラブース	#400ブース
出展内容	パネル展示
その他	主催者のホームページは こちら からご確認ください。